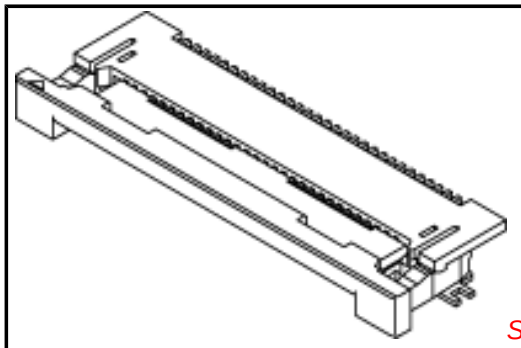
molex
one company > a world of innovation

This document was generated on 06/07/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: 0541323562
Status: Active
Overview: ffc_fpc_smt
Description: 0.50mm (.020") Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Bottom Contact Style, 35 Circuits, 0.1µm (4µ") Gold (Au) Contact Plating



Series image - Reference only

Documents:

3D Model
Drawing (PDF)
Product Specification PS-54132-061 (PDF)
RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

UL	E29179

General

Product Family	FFC/FPC Connectors
Series	54132
Overview	ffc_fpc_smt
Product Name	N/A

Physical

Circuits (Loaded)	35
Color - Resin	Black, Natural
Contact Position	Bottom
Durability (mating cycles max)	20
Entry Angle	90° Angle
Flammability	94V-0
Mated Height (in)	0.079 In
Mated Height (mm)	2.00 mm
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Gold
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Rows	1
Orientation	Right Angle
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface (in)	0.020 In
Pitch - Mating Interface (mm)	0.50 mm
Plating min: Mating (µin)	4
Plating min: Mating (µm)	0.1
Plating min: Termination (µin)	2
Plating min: Termination (µm)	0.05
Polarized to PCB	Yes
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	N/A
Temperature Range - Operating	-20°C to +85°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Wire/Cable Type	FFC/FPC

Electrical

Current - Maximum per Contact	0.5A
Voltage - Maximum	50V

Material Info

Reference - Drawing Numbers

EU RoHS
ELV and RoHS Compliant
REACH SVHC
Not Reviewed
Halogen-Free Status
Not Reviewed

China RoHS

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, click here

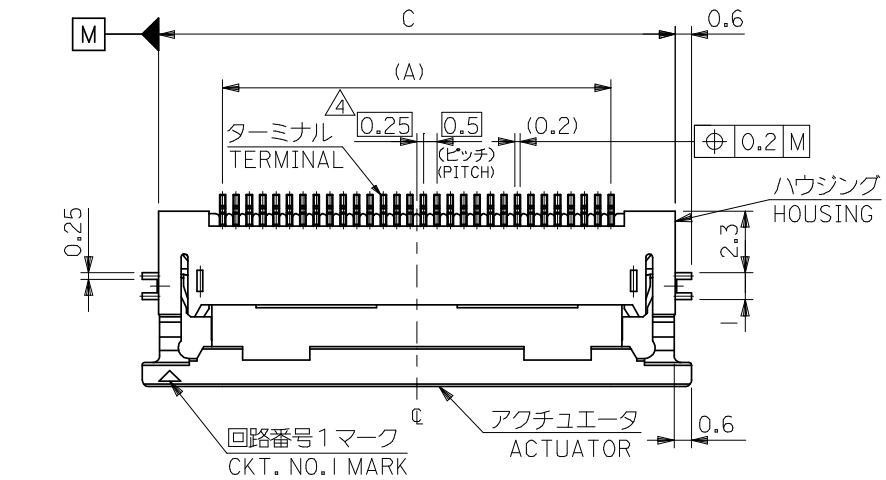
Please visit the Contact Us section for any non-product compliance questions.

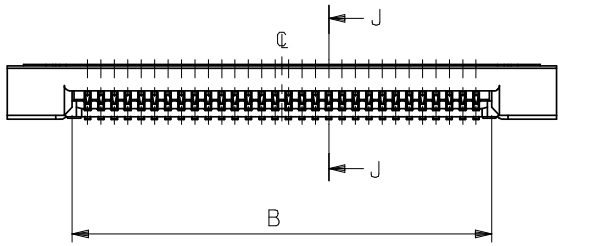
Search Parts in this Series
54132Series

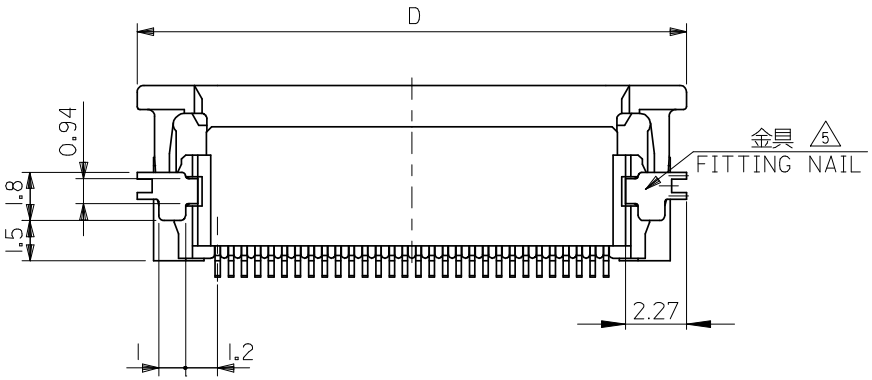
Product Specification	PS-54132-061, RPS-54132-071, RPS-54132-072, RPS-54132-076
Sales Drawing	SD-54132-064

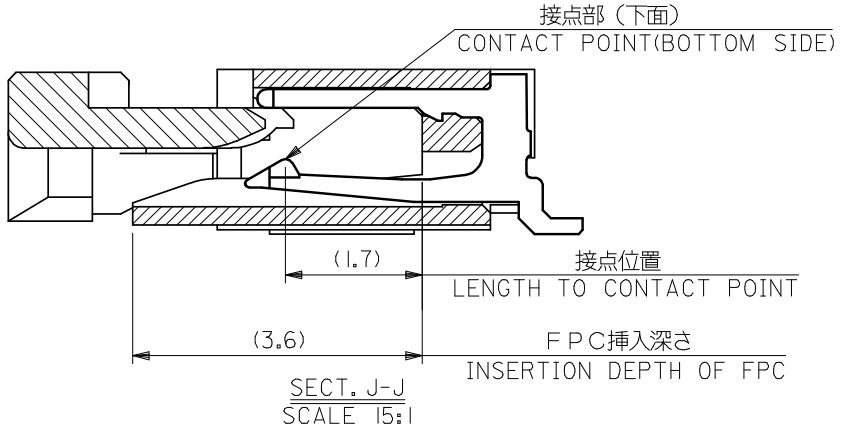
This document was generated on 06/07/2010

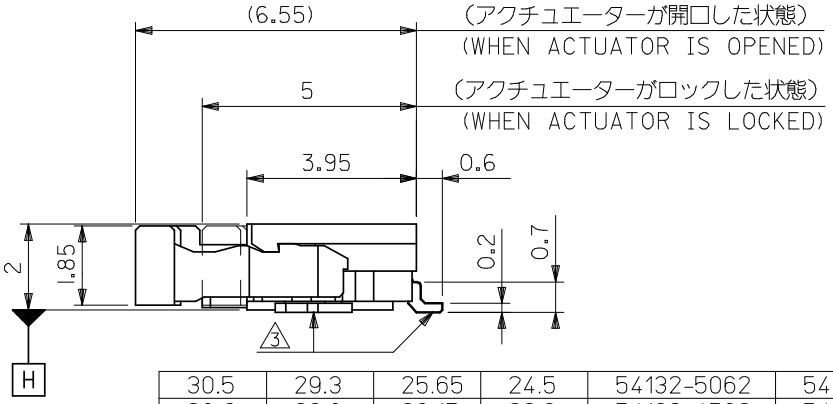
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION











D	C	B	A	EMBOSSED TAPE ORDER No. オーダー番号	MATERIAL. NO.	CKT.
30.5	29.3	25.65	24.5	54132-5062	54132-5068	50
28.0	26.8	23.15	22.0	54132-4562	54132-4568	45
27.0	25.8	22.15	21.0	54132-4362	54132-4368	43
25.5	24.3	20.65	19.5	54132-4062	54132-4068	40
24.5	23.3	19.65	18.5	54132-3862	54132-3868	38
23.5	22.3	18.65	17.5	54132-3662	54132-3668	36
23.0	21.8	18.15	17.0	54132-3562	54132-3568	35
22.5	21.3	17.65	16.5	54132-3462	54132-3468	34
22.0	20.8	17.15	16.0	54132-3362	54132-3368	33
21.5	20.3	16.65	15.5	54132-3262	54132-3268	32
20.5	19.3	15.65	14.5	54132-3062	54132-3068	30

REVISED
EC NO: J2008-4308 2008/06/27
DRWN:MNABEI 2008/06/30
CH'KD:THARUYAMA 2008/06/30
APPR:NUKITA 2008/06/30
DESCRIPTION
REV
M

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE: ---
DESIGN UNITS: METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: M.UMEDA DATE: 2004/09/27
CHECKED BY: K.TOYODA DATE: 2004/09/27
APPROVED BY: N.UKITA DATE: 2004/09/27

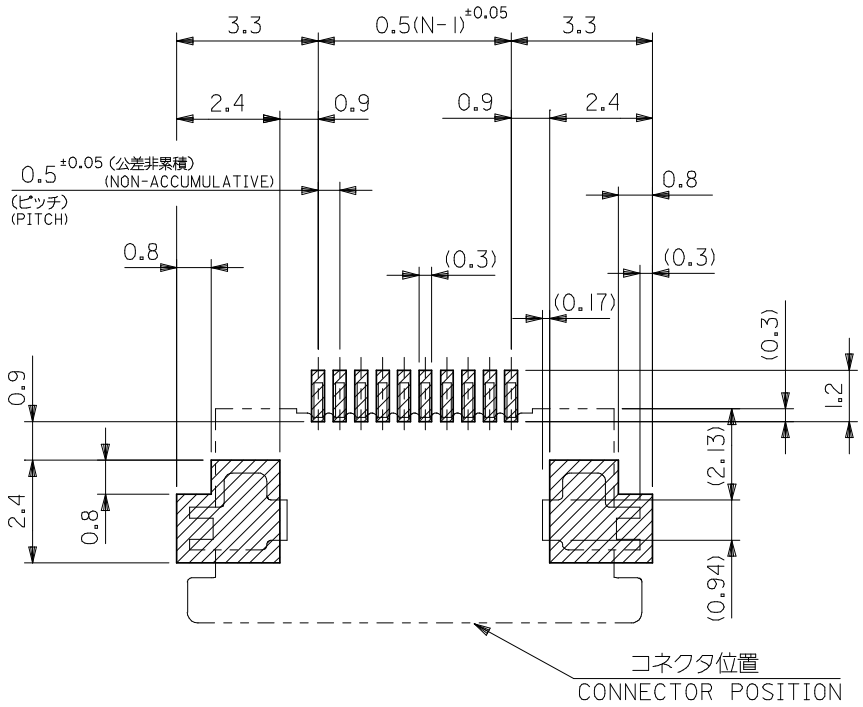
TITLE: 0.5 FPC CONN. HSG ASSY BTM CONTACT GOLD PLATING -LEAD FREE-(NI-BARRIER)

molex MOLEX INCORPORATED

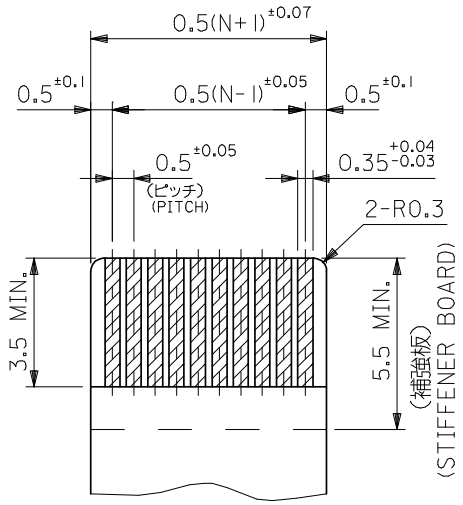
MATERIAL NO.: SEE TABLE
DOCUMENT NO.: SD-54132-064
SHEET NO.: 1 OF 4

SIZE A3

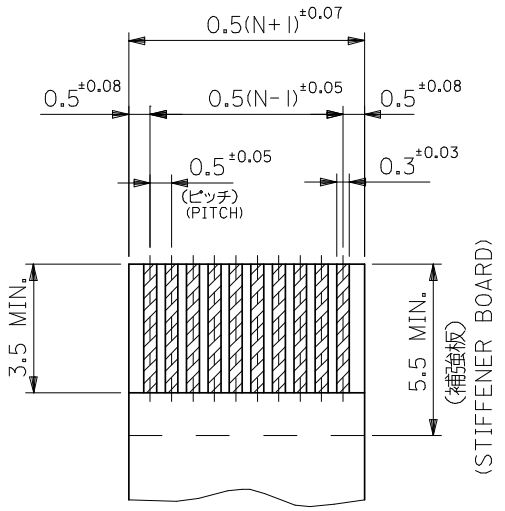
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



参考基板レイアウト
RECOMMENDED PC BOARD PATTERN DIMENSON(REF.)
(マウント面)
(MOUNTING SIDE)



適合ＦＰＣ推奨寸法
APPLICABLE FPC RECOMMENDED DIMENSION
(仕上がり厚さ：0.3±0.03)
(THICKNESS:0.3±0.03)



適合ＦＦＣ推奨寸法
APPLICABLE FFC RECOMMENDED DIMENSION
(仕上がり厚さ：0.3±0.03)
(THICKNESS:0.3±0.03)

注記
NOTES

1．使用材料
MATERIAL

ハウジング HOUSING	：46ナイロン，UL94V−0 :46NYLON
アクチュエーター ACTUATOR	：PPS，UL94V−0 :PPS
ターミナル	:金メッキ コンタクト部 0.1 MICRO METER MIN. テ ー ル 部 0.05 MICRO METER MIN. :ニッケル下地 1.0 MICRO METER MIN.
TERMINAL	:GOLD PLATING CONTCT PORTION:0.1 MICRO METER MIN. TAIL PORTION:0.05 MICRO METER MIN. :NI-PLATING:0.1 MICRO METER MIN.
金具	:リン青銅（t=0．2）、錫メッキ 1．0~3．0 MICRO METER MIN. ニッケル下地 1．0~3．0 MICRO METER MIN.
FITTING NAIL	:PHOS-BRO,TIN-PLATE 1．0~3．0 MICRO METER MIN. OVER NICKEL 1．0~3．0 MICRO METER MIN.

2．エンボステープ梱包時は、アクチュエーターがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.54132-**69 SHOULD BE LOCKED.

3 ソルダーテール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、基準面 H に対し上方向0．1MAX．下方向0．15MAX．とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAIL FROM H UPPER DIRECTION:0.1 MAX.,LOWER DIRECTION:0.15MAX.

4 偶数極に適用
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

5 パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.

6. 本製品は54132−**61に対するニッケルバリア品である．
THIS PRODUCT IS Ni-Barrier OF 54132-**61.

FPC/FFCについて：
打抜き方向は導体側から補強板側を推奨いたします。
導体部については軟銅箔35マイクロメーターまたは50マイクロメーター
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:
FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC.:
THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 micrometer or 50 micrometer

FPCについて：
補強フィルム材質はポリイミドを推奨いたします。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨いたします。
RECOMMENDED MATERIAL:
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

REVISED
E EC NO: J2008-4308 2008/06/27
DRWN:MNABEI 2008/06/30
CH'KD:THARUYAMA 2008/06/30
APPR:NUKITA
DESCRIPTION
REV

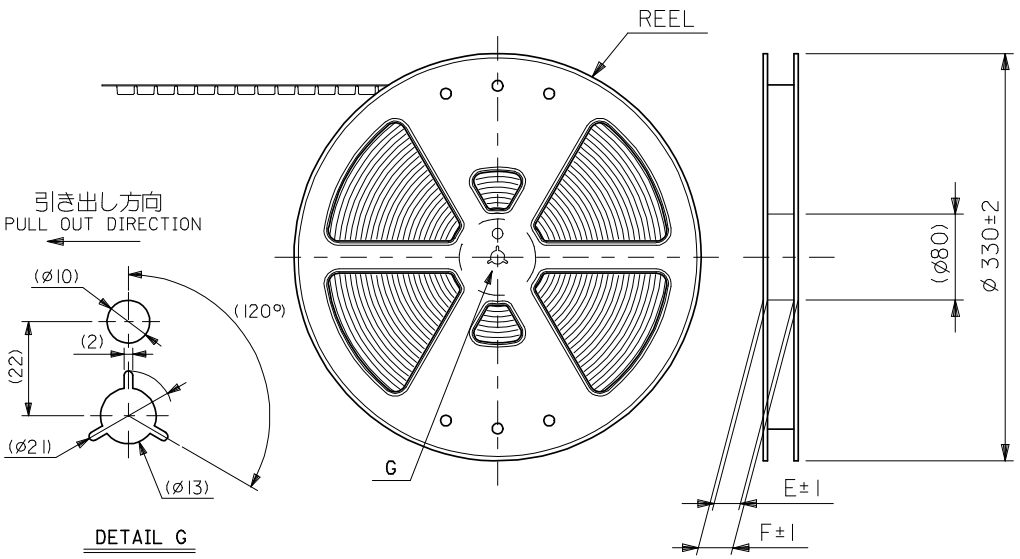
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

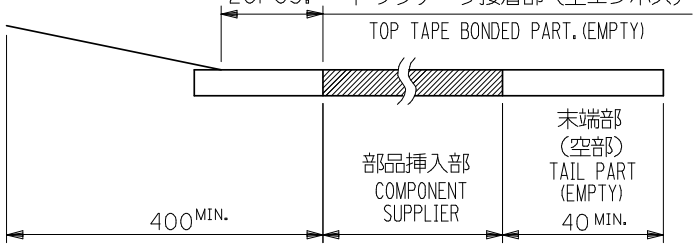
DIMENSION STYLE	MM ONLY
SCALE	---
DESIGN UNITS	METRIC
	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY / DATE	M.UMEDA 2004/09/27
CHECKED BY / DATE	K.TOYODA 2004/09/27
APPROVED BY / DATE	N.UKITA 2004/09/27
TITLE	0.5 FPC CONN. HSG ASSY BTM CONTACT GOLD PLATING -LEAD FREE-(NI-BARRIER)
	MOLEX INCORPORATED
MATERIAL NO.	SEE SHEET 1
DOCUMENT NO.	SD-54132-064
SHEET NO.	2 OF 4
SIZE	A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



DETAIL G

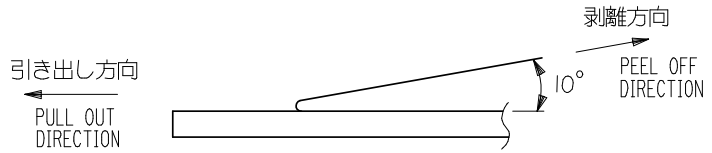
引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



NOTES

1. 梱包数量：１５００個／リール
   NUMBER OF CONNECTORS : 1500PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

3. トップテープの剥離強度： 0.1N ～ 1.3N{10gf ～ 130gf}
   （剥離方向は下図参照）
   尚、本規格値は出荷時に適用。（但し、輸送時に剥離が発生しないこと。）
   PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ～ 1.3N{10gf ～ 130gf}
   (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG,)
   THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
   PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



5. 材料　キャリアテープ：ポリプロピレン（ＰＰ）
   トップテープ：ＰＥＴ，ＰＥ，ＰＥＦ
   リール：ポリスチレン（ＰＳ）<リサイクル材を含む>

   MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
   TOP TAPE:PET,PE,PEF
   REEL:POLYSTYREN(PS)
   <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

6. 本製品は54132−＊＊61に対するニッケルバリア品である．
   THIS PRODUCT IS Ni-Barrier OF 54132-**61.

REVISED			
EC NO: J2008-4308	2008/06/27		
DRWN:MNABEI	2008/06/30		
CH'KD:THARUYAMA	2008/06/30		
APPR:NUKITA			

DESCRIPTION

REV E

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±---
10 OVER 30 UNDER	±---
30 OVER	±---
ANGULAR	±--- °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY	SCALE: ---	DESIGN UNITS: METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY: M.UMEDA	DATE: 2004/09/27		
CHECKED BY: K.TOYODA	DATE: 2004/09/27		
APPROVED BY: N.UKITA	DATE: 2004/09/27		
MATERIAL NO.: SEE SHEET 4			

TITLE: 0.5 FPC CONN. HSG ASSY BTM CONTACT GOLD PLATING -LEAD FREE-(NI-BARRIER)

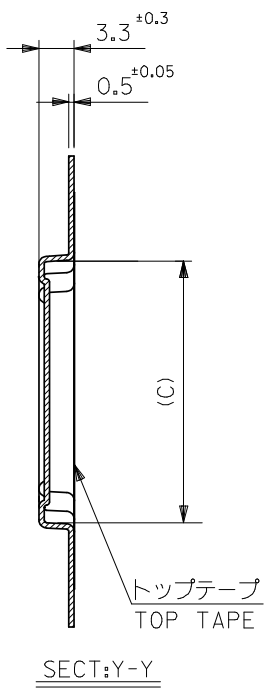
molex MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.: SD-54132-064

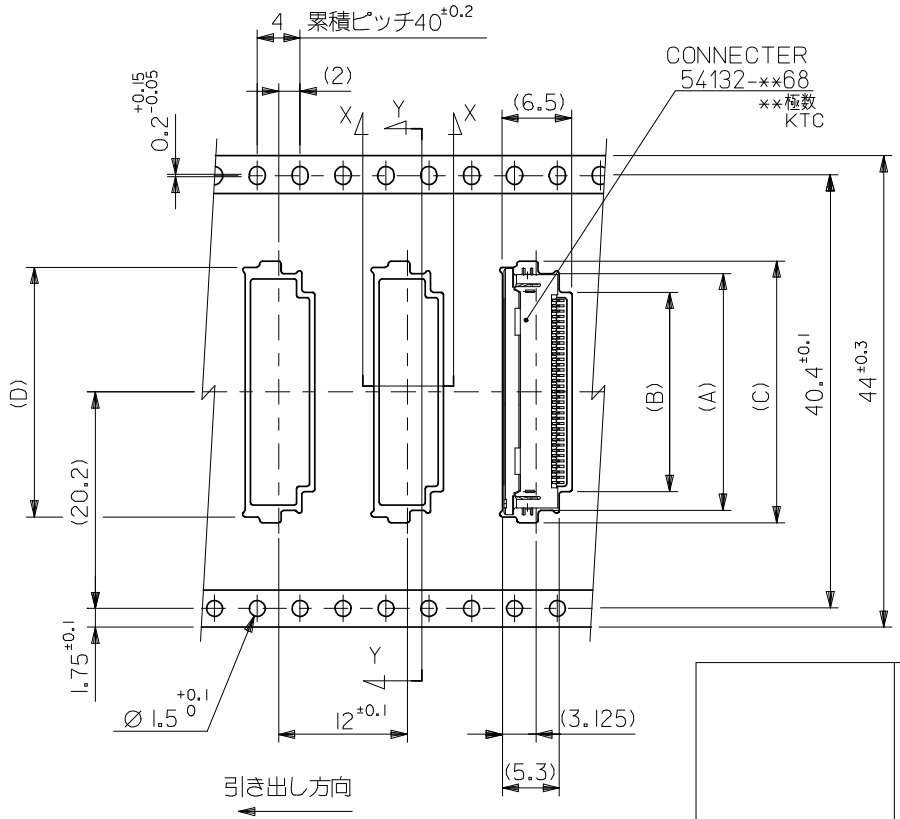
SHEET NO.: 3 OF 4

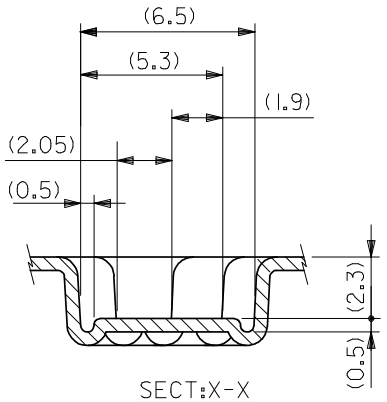
SIZE A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



SECT:Y-Y





SECT:X-X
(SCALE 5:1)

			30.8	31.9	26.1	29.6	54132-5062	50
			28.3	29.4	23.6	27.1	54132-4562	45
			27.3	28.4	22.6	26.1	54132-4362	43
			25.8	26.9	21.1	24.6	54132-4062	40
			24.8	25.9	20.1	23.6	54132-3862	38
44	49.4	45.4	23.8	24.9	19.1	22.6	54132-3662	36
			23.3	24.4	18.6	22.1	54132-3562	35
			22.8	23.9	18.1	21.6	54132-3462	34
			22.3	23.4	17.6	21.1	54132-3362	33
			21.8	22.9	17.1	20.6	54132-3262	32
			20.8	21.9	16.1	19.6	54132-3062	30
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	F	E	D	C	B	A	MATERIAL NO. (EMBOSS PKG)	CKT.

REVISED
E1 EC NO: J2008-4308 2008/06/27
DRWN:MNABEI 2008/06/30
CH'KD:THARUYAMA 2008/06/30
APPR:NUKITA 2008/06/30
DESCRIPTION
REV

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±---
10 OVER 30 UNDER	±---
30 OVER	±---
ANGULAR	±--- °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE: ---
DESIGN UNITS: METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: M.UMEDA DATE: 2004/09/27
CHECKED BY: K.TOYODA DATE: 2004/09/27
APPROVED BY: M.UMEDA DATE: 2004/09/27
MATERIAL NO.: SEE TABLE

TITLE: 0.5 FPC CONN. HSG ASSY BTM CONTACT GOLD PLATING -LEAD FREE-(NI-BARRIER)

molex MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.: SD-54132-064
SHEET NO.: 4 OF 4
SIZE: A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А